

3-104074-0 ! 试产

AMPMODU | AMPMODU System 50

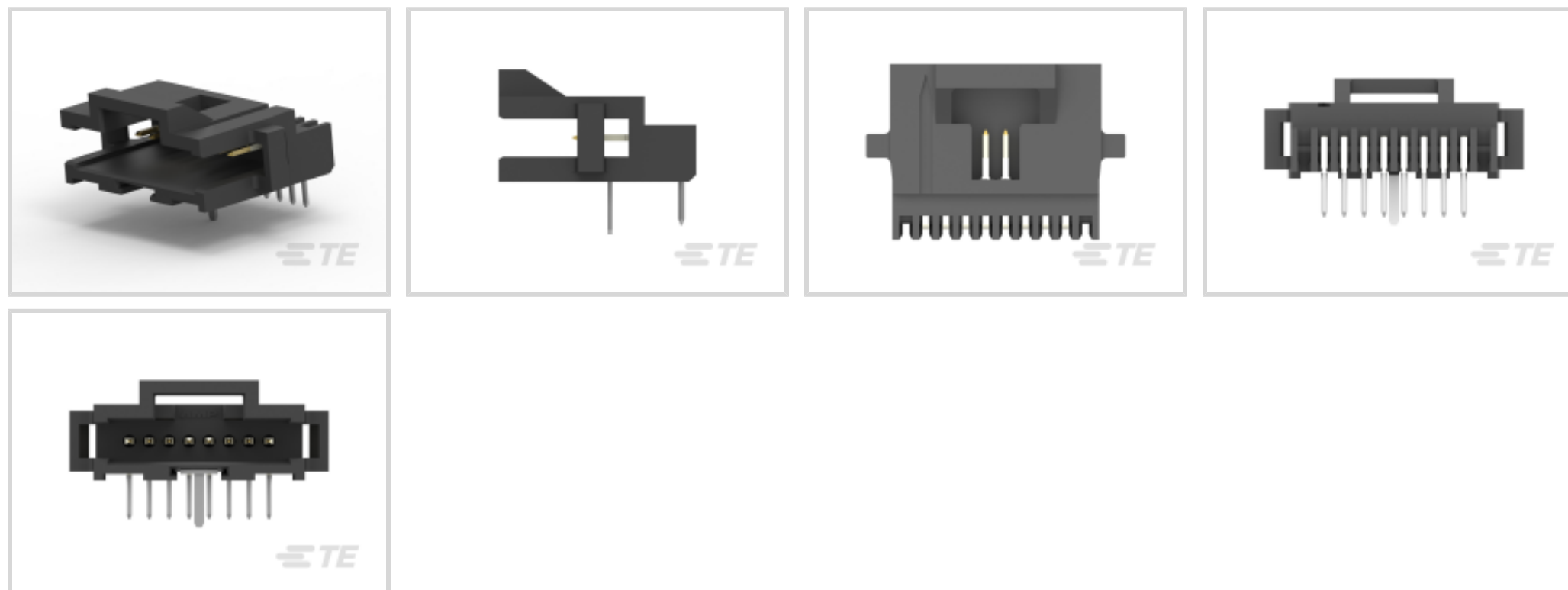
TE 内部编号 3-104074-0

PCB Mount Header, Right Angle, Board-to-Board, 8 Position, 1.27 mm [.05 in] Centerline, Fully Shrouded, Gold, Through Hole - Solder, AMPMODU System 50

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



连接器系统: 板对板

位数: 8

行数: 1

中心线 (间距) : 1.27 mm [.05 in]

PCB 安装方向: 直角

产品特性

产品类型特性

| | |
|-------------|----------|
| 连接器系统 | 板对板 |
| 接头类型 | 全部带罩 |
| 可密封 | 否 |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 |
| PCB 连接器组件类型 | PCB 安装接头 |

结构特性

| | |
|-----------|----|
| 板对板配置 | 垂直 |
| 连接器端子负载状态 | 满载 |
| 位数 | 8 |
| 行数 | 1 |
| PCB 安装方向 | 直角 |

电气特征

| | |
|------------|---------|
| 介质耐压 (最大值) | 500 VAC |
| 绝缘电阻 | 5000 MΩ |

| | |
|------|--------|
| 工作电压 | 30 VAC |
|------|--------|

主体特性

| | |
|--------------|--------|
| PCB 保持特性电镀材料 | 镍打底镀锡铅 |
| 连接器外形 | 标准 |
| 主要产品颜色 | 黑色 |

接触件特性

| | |
|--------------------|---|
| PCB 端子端接区域电镀材料厚度 | 3.81 – 6.35 μm [150 – 250 μin] |
| 端子接合区域电镀材料厚度 | .03 μm [1.18 μin] |
| PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层 | 哑光 |
| 端子形状和构造 | 矩形 |
| 端子底板材料 | 镍 |
| PCB 端子端接区域电镀材料 | 锡铅 |
| 端子基材 | 铜合金 |
| 端子接触部电镀材料 | 金 |
| 端子类型 | 插针 |
| 端子额定电流 (最大值) | 3.6 A |

端接特性

| | |
|-----------|----------------|
| 端接柱体和尾部长度 | 2.54 mm[.1 in] |
| PCB 端接方法 | 通孔 - 焊接 |

机械附件

| | |
|------------|--------|
| 接合对准类型 | 极化, 极化 |
| 接合固定 | 带有 |
| PCB 安装固定类型 | 压具柱体 |
| 接合固定类型 | 闭锁 |
| 连接器安装类型 | 板安装 |
| 接合对准 | 带有 |
| PCB 安装对准 | 不带 |
| PCB 安装固定 | 带有 |

壳体特性

| | |
|----------|-----------------|
| 外壳材料 | LCP |
| 中心线 (间距) | 1.27 mm[.05 in] |

尺寸

| | |
|-------------|------------------|
| PCB 厚度 (建议) | 1.57 mm[.062 in] |
|-------------|------------------|

使用环境

| | |
|---------|----------------------------|
| 壳体温度额定值 | 高 |
| 工作温度范围 | -65 – 105 °C[-85 – 221 °F] |

操作/应用

| | |
|--------|--------|
| 焊接工艺特性 | 板支座 |
| 电路应用 | Signal |

行业标准

| | |
|-------------|-----------------------|
| UL 等级 | 获得认可 |
| 与机构/标准产品兼容 | CSA, UL |
| 与已批准的标准产品兼容 | CSA LR7189, UL E28476 |
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |

包装特性

| | |
|------|-----------|
| 封装方法 | Box, Tube |
|------|-----------|

其他

| | |
|----------|---|
| 已忽略的装载位置 | 0 |
|----------|---|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

| | |
|--|---|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 未进行合规性审核 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC | 未进行合规性审核 |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令) | 未针对中国 RoHS 符合性进行审核 |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) 尚未进行合规性审核 |
| 卤素含量 | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。 |
| 焊接工艺能力 | 波峰焊接可达到 260°C |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的物品中高度关注物质含量(SVHC)信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)“物品中物质的要求指南”(2011年4月第2版)，在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE注意到欧洲法院

在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



该系列中的其他产品 | AMPMODU System 50



客户还购买了



文档

产品图纸



08 SYS 50 HDR SRRA SHRD, AU FL

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-104074-0_1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-104074-0_1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-104074-0_1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本